

M117 M117B 封装尺寸工程变更通知书

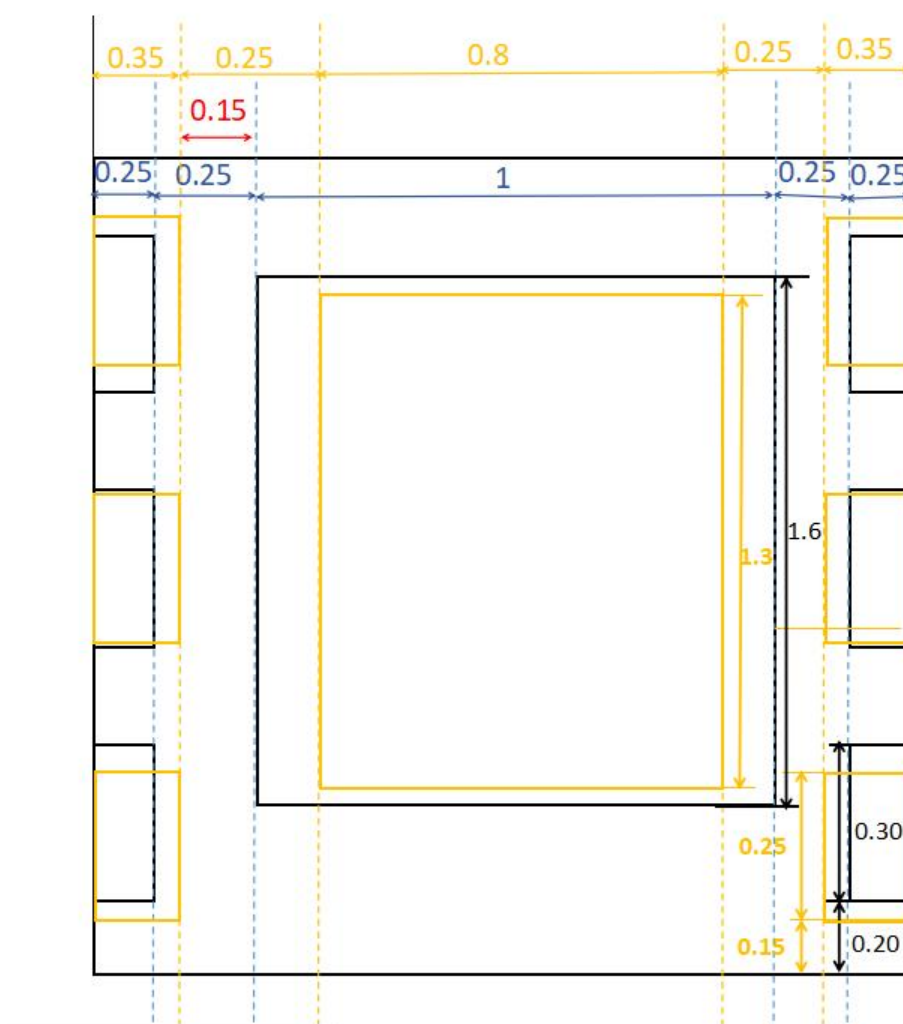
尊敬的客户：

您好！

我司数字温度芯片 M117、M117B 系列，DFN6L 封装，典型测温精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 或 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，因封装框架产线发生变更，封装引脚尺寸 POD 发生微小变动，如下做出具体说明，给大家带来的设计变更深表歉意！

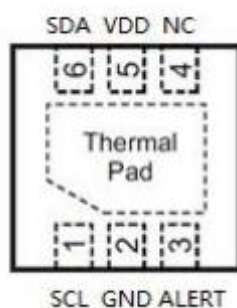
- 两种封装 POD 尺寸区别：

M117 M117B DFN6L 尺寸图

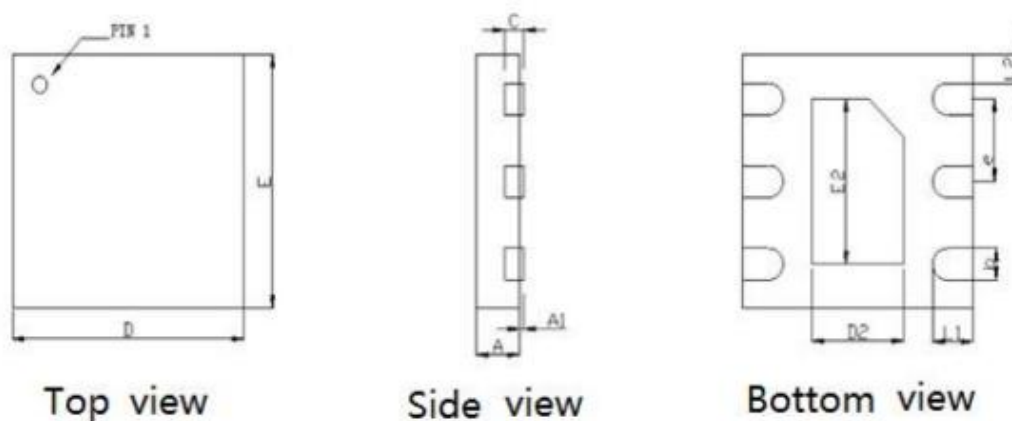


注：黄色为 V1 版框架尺寸；
黑色为新版 V2 版框架尺寸。

新旧版本 PIN 角定义不变，如下：

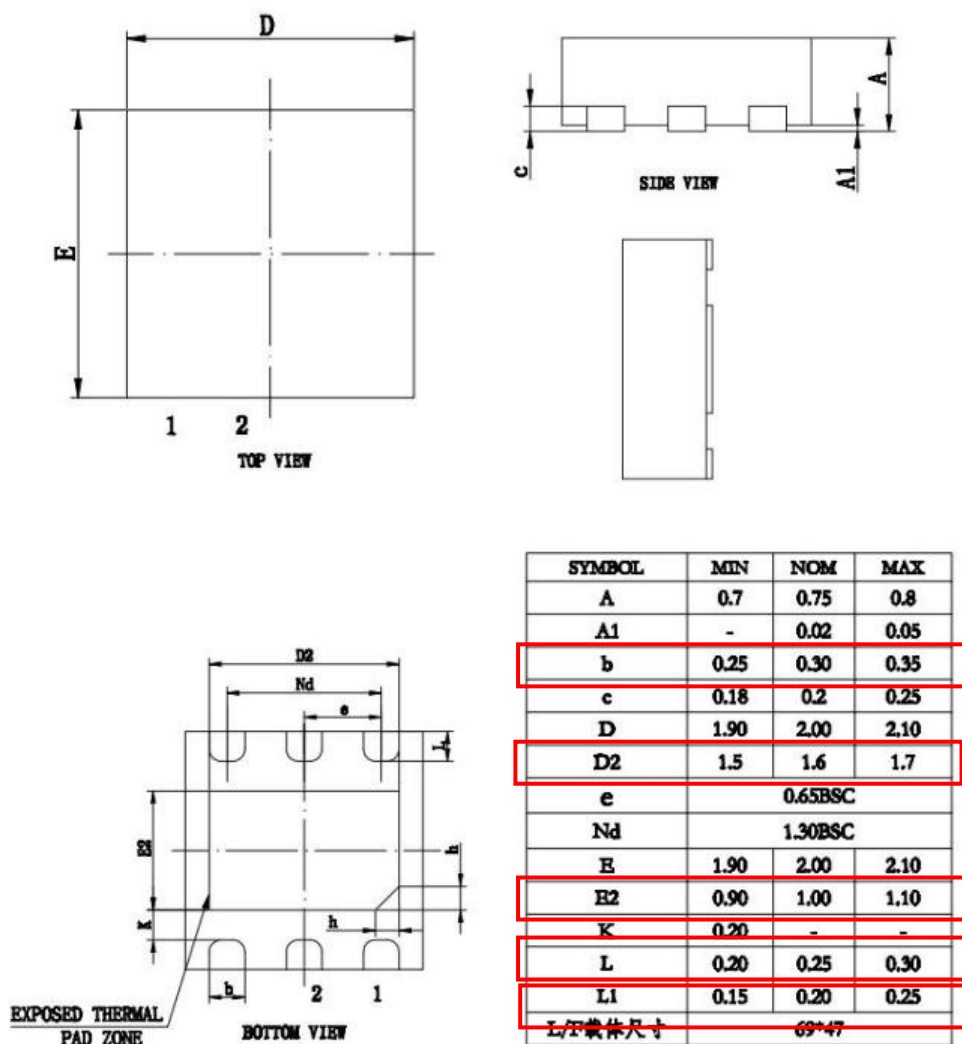


● V1 版 M117 M117B 封装尺寸：



Symbol	Millimeters			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	0.70	0.75	0.80	0.028	0.030	0.031
A1	0.00	0.02	0.02	0.000	0.001	0.002
b	0.22	0.25	0.28	0.009	0.010	0.011
C	0.20			0.008		
D	1.90	2.00	2.10	0.076	0.080	0.084
D2	0.77	0.80	0.83	0.030	0.032	0.033
E	1.90	2.00	2.10	0.076	0.080	0.084
E2	1.27	1.30	1.33	0.050	0.052	0.053
e	0.650 BSC			0.026		
L1	0.30	0.35	0.40	0.012	0.014	0.016
L2	0.100	0.150	0.200	0.004	0.006	0.008

● V2 版 M117 M117B 封装尺寸:



注: V1、V2 尺寸变化部分红框标记。

我司竭诚支持您进行芯片版本更换工作, 若有问题请联系我司, 我们全力配合寻找解决方案。再次感谢您的支持与配合!

浙江敏源传感科技有限公司
 邮箱: sales@mysentech.com
 电话: 18057318230
 2022 年 12 月